

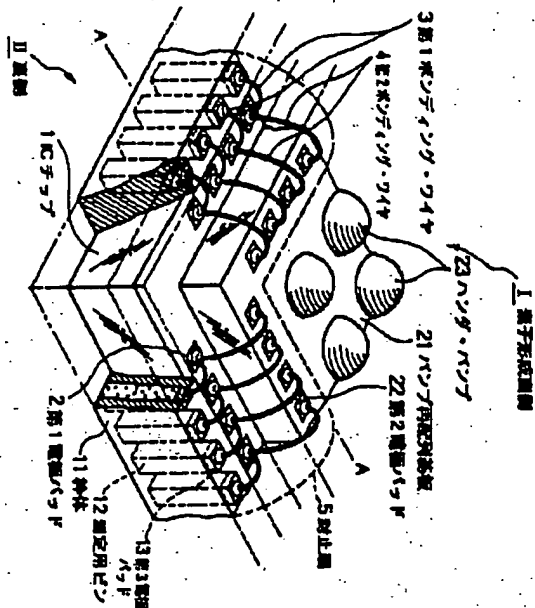


本発明は、半導体素子のパッケージング技術に係る。従来、半導体素子のパッケージング技術として、半導体素子の表面に、ICチップの構成の細部、各部材の寸法、各部材の構成材料については適宜変更や選択が可能である。

【0018】

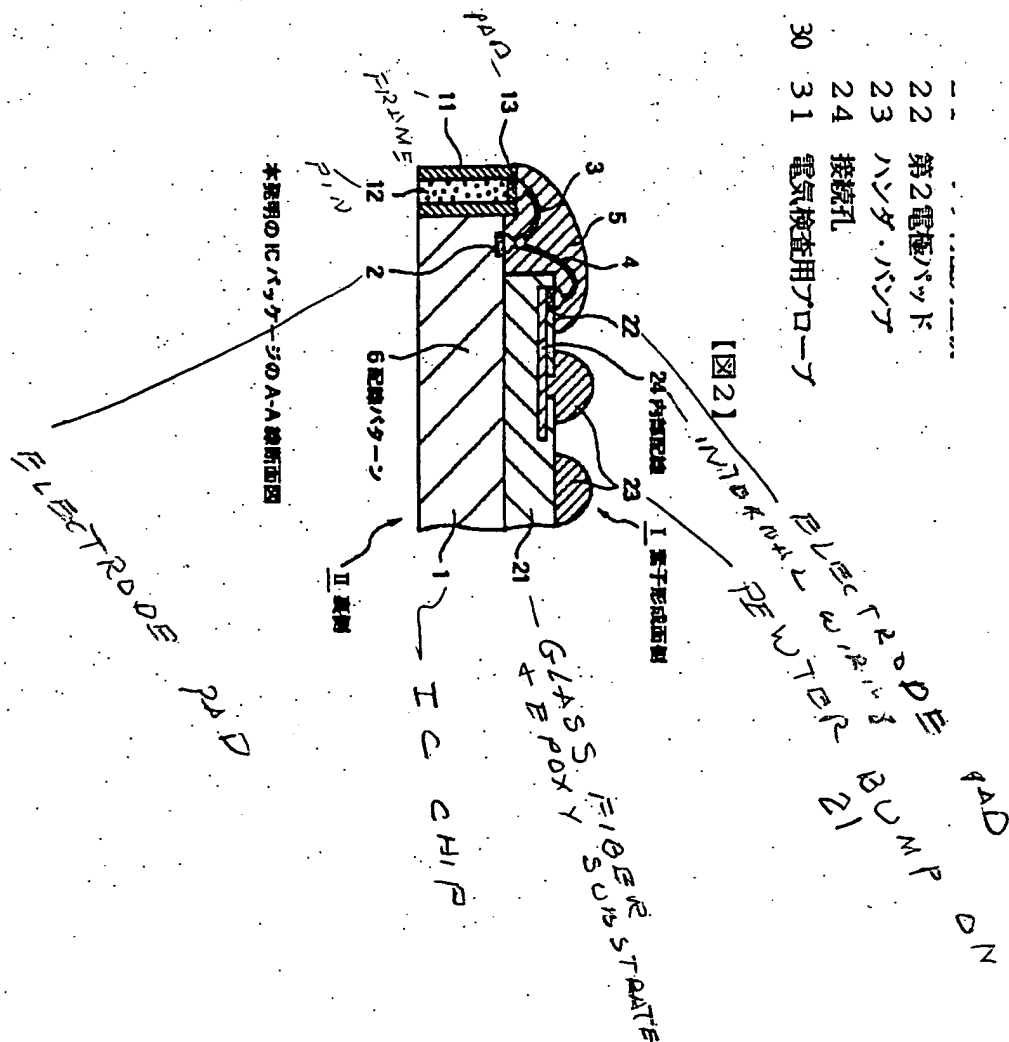
【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発明は、半導体素子のパッケージング技術に係る。

【図1】



本発明のICパッケージの一部

【図2】



本発明のICパッケージのA-A線断面図